

타원법의 원리 및 응용

Ellipsometry - Principle and its Application

김 상 열
 아주대학교 자연대학
 sykim@madang.ajou.ac.kr

약 100여 년 전에 드루드(Drude)에 의해 발견된 시료 표면에서 반사된 빛의 편광상태 변화가 물질의 광학적 성질과 박막의 두께에 예민하다는 사실에 기초하는 타원법(ellipsometry)은 다음과 같은 몇 가지 고유한 장점으로 인하여 표면 나노 층구조 및 광물성 분석장비로써 크게 주목을 받고 있다.

첫째, 광학적인 장비로 전자나 이온을 사용하는 표면분석장비와는 달리 진공을 필요로 하지 않고 고밀도 플라즈마 심지어는 액체매질에서도 측정이 가능하여 매질에 따른 제약이 없다. 더구나 *in situ*, 실시간 측정이 가능하며 측정과정이 시료와 간섭하지 않는 점도 장점으로 추가된다.

두 번째 장점은 진폭과 위상을 측정함으로써 유래한다. 2상계 시료의 복소굴절률을 결정하고 3상계 시료의 산화막이나 표면층을 원자부분층(atomic partial coverage)까지 파악하므로 깨끗한 표면을 확인할 수 있으며 물질의 광학상수(복소굴절률)를 정확하게 측정할 수 있다. 또한 기층에서 박막으로의 계면 급준성이나 원자나 분자 또는 이온 등의 흡, 탈착 및 산화와 식각 과정, 표면처리에 따르는 표면상태의 변화, 전해질 내 금속표면의 산화막 또는 부동화 보호막의 형성, 표면 플라즈몬 연구 등에서 많은 응용 예를 찾아볼 수 있다.

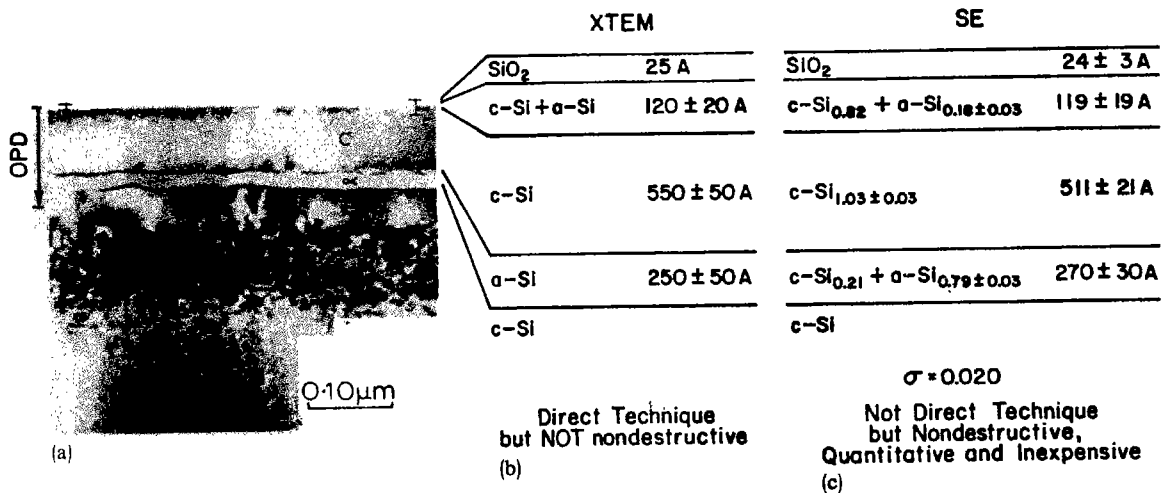


그림 1. 분광타원법을 사용하여 결정한 Si+ 주입된 Si 단결정의 다층구조 깊이윤곽을 XTEM 을 사용하여 결정한 다층구조의 깊이윤곽과 비교한 그림. 두께와 결정성 분석에서 분광타원법의 정량적인 분석능력을 확인할 수 있다.[McMarr 등, APL, 47(4), 339 (1985)]

세번째 장점은 컴퓨터의 발달로 인해 타원계(ellipsometer)의 자동화, 데이터 획득속도 및 정밀도 향상, 그리고 분광능력의 확보에 기초한다. 모델링방법을 기초로 한 분광타원계(spectroscopic ellipsometer, SE)의 정량적인 다층구조의 깊이윤곽(depth profile) 분석이 반도체 시료를 중심으로 시작되어 미지 물질의 광학상수결정 및 다층구조 깊이윤곽에 관한 연구가 하나의 연구 흐름을 형성하였다. 유전체는 물론 금속이나 반도체 등 빛을 흡수하는 물질의 복소굴절률과 다층박막구조를 결정하는 연구들이 수행되고 있다.

본 강의에서는 편광에 관한 기본이론과 타원측정 및 데이터분석 방법 등을 간단히 설명하고 타원법의 응용 분야를 몇 가지 대표적인 예를 통하여 소개하고자 한다. 산화막의 정밀두께 측정과 성장과정의 모니터링, in-situ 측정(식각, 박막성장, 상변화 과정) 등 단파장에서의 응용 예와 분광타원계를 사용한 다층구조의 깊이윤곽, 미지 유전체 박막의 분산관계식 및 다층구조 결정, 그리고 반도체나 도체 등의 표면 구조 및 광물성 결정 등 분광타원법에서의 응용예를 다루고자 한다.

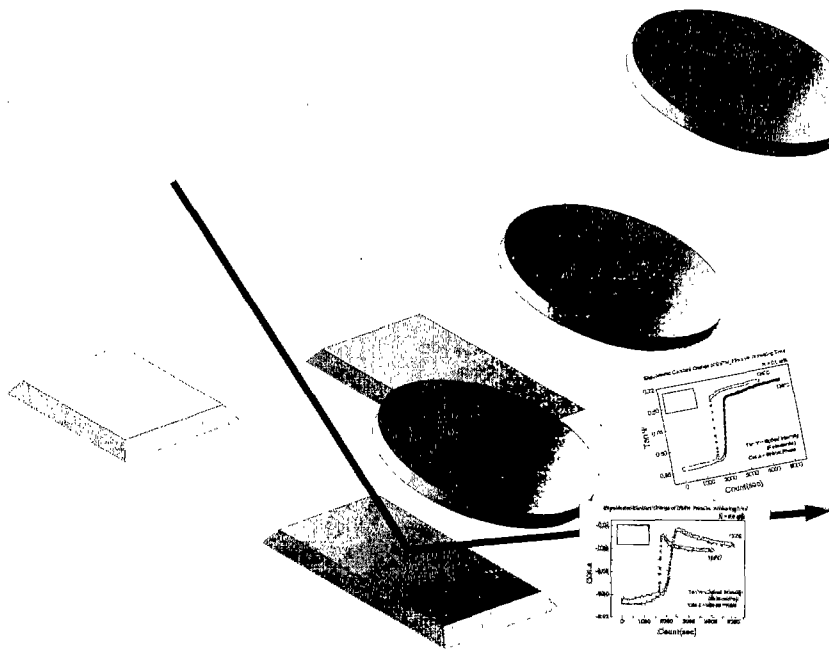


그림 2. 상변화 광기록매체인 Ge-Sb-Te 합금의 상변화 과정을 in-situ 타원법을 사용하여 측정하는 개념도.